

令和7年 11 月 21 日

京都ものづくり部品相互融通プラットフォーム終了のお知らせ

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本府では、令和4年度より京都府内のものづくり企業間における部品・資材の相互融通を目的として「京都ものづくり部品相互融通プラットフォーム」を運営してまいりましたが、この度、設立当初の目的を達成したことから令和7年11月28日をもちましてサービスを終了させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。

これまで本プラットフォームを多くの会員企業の皆様にご活用いただき、地域産業の連携強化に御尽力いただきましたことに、厚くお礼申し上げます。今後とも、京都府のものづくり産業の振興ならびに府政推進に対し、格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、本取組は半導体、回路部品等の世界的な不足を背景に始めた取組ですが、令和7年度からは「京都次世代半導体産業推進事業」として、半導体関連企業や大学等との交流の場づくりやビジネスマッチング支援に取り組んでおります。本事業に関する情報提供をご希望の場合は以下までお問合せください。

《問合せ先》 京都府商工労働観光部産業振興課
TEL:075-414-4851/FAX:075-414-4842
E-MAIL:sangyoshinko@pref.kyoto.lg.jp